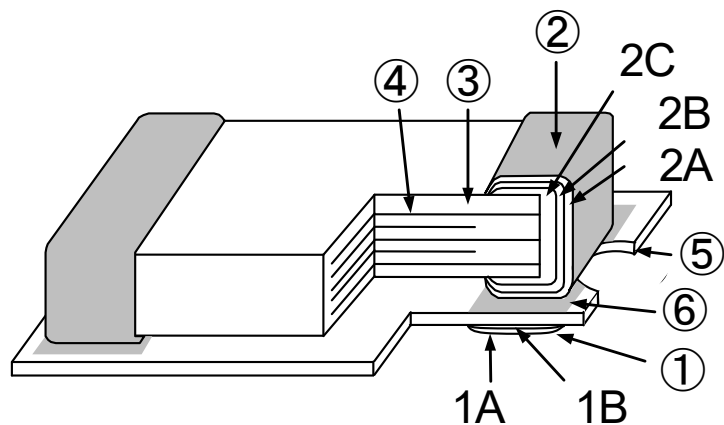


## インターポーザ基板付きチップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表

### Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor on Interposer

<ZRA Series>

#### 1.内部構造/Structure



#### 2.材料名/Material

No.	名称 Name	主原料 Material
①	外部電極/Termination	
1A	めっき層/Plated layer	すず/Tin
1B	下地電極/Electrode	銅/Copper
②	MLCC 外部電極/MLCC Termination	
2A	MLCC めっき層/MLCC Plated layer	すず/Tin
2B	MLCC めっき層/MLCC Plated layer	ニッケル/Nickel
2C	MLCC 下地電極/MLCC Electrode	銅/Copper
③	MLCC 誘電体素子/MLCC Dielectric layer	チタン酸バリウム系/Ceramic
④	MLCC 内部電極/MLCC Inner electrode	ニッケル/Nickel
⑤	インターポーザ基板/Interposer	ガラスエポキシ/Glass Epoxy
⑥	接続はんだ/Solder	無鉛はんだ(すず・銀・銅系)/ Lead Free Solder(Tin-Silver-Copper series)

J(E)MCZ0-1R0684C

<ご参考> 当社ウェブサイトにて、各シリーズの最新の構造図を手いいただくことが可能です。 → [構造図/材料表](#)

<Reference> The latest structure diagrams of each series are available on our website. → [Structure diagram, Materials chart](#)